

DICING SERVICE FÜR WAFER UND KERAMIK

Materialien	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aluminiumoxid ▪ Aluminiumnitrid ▪ PZT-Keramik ▪ Quarzglas ▪ Glas ▪ Silizium ▪ andere auf Anfrage
Wafergrößen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ max. 6"
Waferdicken	<ul style="list-style-type: none"> ▪ min. 200 µm (darunter auf Anfrage) ▪ max. 750 µm
Sägegrabenbreite	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Silizium: min. 75 µm ▪ andere: min. 100 µm
Chipping	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Silizium: max. 10 µm ▪ andere: max. 50 µm
Folien	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Standard: 150 µm UV-Tape ▪ Blue Tape
Lieferformen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ auf Tape/Frame ▪ Waffle Pack
Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ schnelles Prototyping ▪ Bearbeitung kleiner Stückzahlen
Bemerkungen	<p>Der Sägegraben sollte frei von Metallisierungen sein. Bei galvanischen Schichten mit einer Dicke von über 1 µm im Sägegraben ist ein Trennen in o. g. Qualität nicht möglich.</p>